

2026年5月13日

2025年度 通期業績説明会 Q&A

No.1	Q. 第2期中期経営計画を策定した11月と比べると、金価格の高騰やSiC事業の減損計上等、さまざまな環境の変化が出ているが、構造改革による利益改善の進捗は。またFY27における改善見通しに変化はあるか。
	A. FY26における利益改善効果は当初想定通り実現できる見通し。金価格の高騰については、FY26より価格転嫁を実施しているが、より構造的な施策として金から銅への材料置換を進めている。FY27における構造改革の効果は、生産拠点再編や銅への置き換えが進むことでより大きくなる。
No.2	Q. 東芝デバイス&ストレージ株式会社との統合が進んだ場合、生産拠点再編の計画やデータセンター向け売上など、事業にどう影響するか。
	A. 仮に統合が実現した場合は、拠点構成の変化に応じて生産戦略の見直しが必要になる。特にパワーデバイスでは6インチから8インチ、あるいは12インチへの大口径化を進めることになる。また、東芝デバイス&ストレージ株式会社はデータセンター向けに高性能なSi MOSFETを保有しているため、同分野については売上拡大の可能性があると見ている。
No.3	Q. 国内の自動車OEMがBEV（バッテリー式電気自動車）の生産計画を見直すなど事業環境が大きく変わる中、車載向けインバータの需要見通しをどのように見ているか。また計画見直しに伴うOEM等からの求償の受け取りなどは発生するか。
	A. 現時点の見通しに基づくと、BEVの生産計画見直しの影響は2029年以降に顕在化すると見ている。2028年までは、EV向けの減少分をHEV（ハイブリッド車）におけるSiC採用の拡大が補完するため、全体として従来見通しから大きな変更はない。見直しの対象となった計画は2029年以降に始まるものが多く、これに関わる求償の受け取りはない。
No.4	Q. デンソーとは既存の戦略的パートナーシップに基づく協業の可能性について協議を継続するとのことだが、協業強化におけるローム側のメリットは何か。また、現状はアナログICでの協業が中心だが、パワー半導体の分野での協業の可能性はあるか。
	A. 現在協業しているアナログIC分野において、デンソーは車載市場で培った高い信頼性技術を有しており、ロームが持つ販路と組み合わせることで、互いに産機・民生分野の新たな市場を開拓できる可能性がある。パワーは他社と協業されているため、アナログにフォーカスする。
No.5	Q. SiC事業の黒字化時期がFY28である点は前回（上期決算説明会、25年11月7日）から変化なく、FY28の想定利益についても前回並みに見える。これは、減損損失の影響を考慮してもFY28の想定利益が前回想定値並み、という理解で良いのか。
	A. 減損損失による償却費の減少効果は発生しており、損益分岐点は前回想定より下がっている。グラフはあくまで黒字化に向けた道筋を示す目的で掲載したものであり、SiC事業が黒字化を達成した場合、FY28の利益水準は前回想定を上回る可能性がある。
No.6	Q. AIサーバー向けのDrMOS・MPCについて。特定顧客に特化した製品を展開するのか、それとも顧客を限定せずに広く展開するのか。広く展開する場合、現状のキャパシティで対応可能か。
	A. 特定顧客向けのカスタム品というより汎用性の高い標準品に近い位置づけであり、それぞれの製品は他社にも横展開が可能。GPU/CPUによってインターフェース等の仕様は変わるが、基本となるチップは共通化が可能。最終的には同一のチップで複数ベンダーに対応できる製品開発を目指す。キャパシティについては、28年まで大規模投資は不要と想定しているが、それ以降は需要動向に応じて設備投資やアウトソーシングを検討する。

No.7	Q. PMIC などを手掛ける他のアナログ半導体メーカーが DrMOS や MPC 領域にも参入してくることで競争が激化する可能性があるか。
	A. お客様からはピン構造などの互換性を要求されるところがあり、競合製品の存在がこちらの製品の販売の前提になる場合がある。競合とは競い合うところもあれば、協力し合うところもあると考えている。
No.8	Q. 東芝デバイス&ストレージ株式会社や三菱電機株式会社のパワー半導体事業との統合について、最終的に目指す姿をどのように考えているか。
	A. まだ詳細を公表できる段階にないが、ロームと東芝は半導体事業全体での統合を目指している。その中のパワー半導体事業については、三菱電機も含めた 3 社で世界で競争力のある事業体を設立することを目指している。